



ミタチ産業・日邦産業 業務提携 展開商材 第2弾

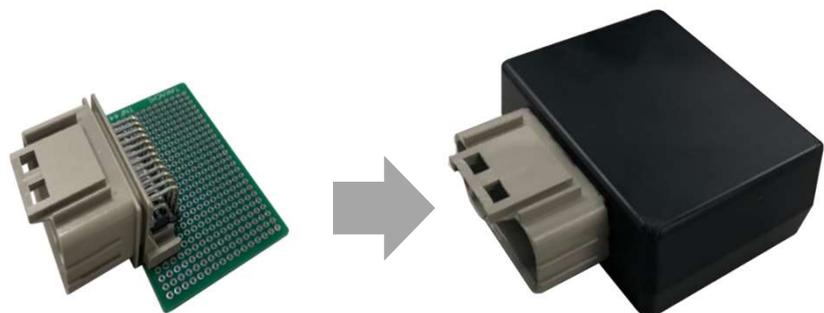
「電子部品一括封止プロセスのご提案」

コンセプト

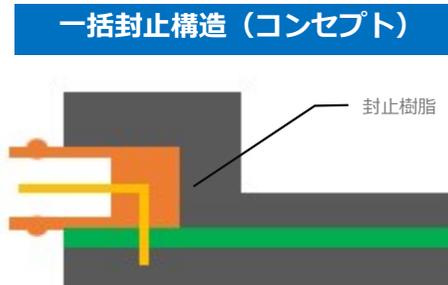
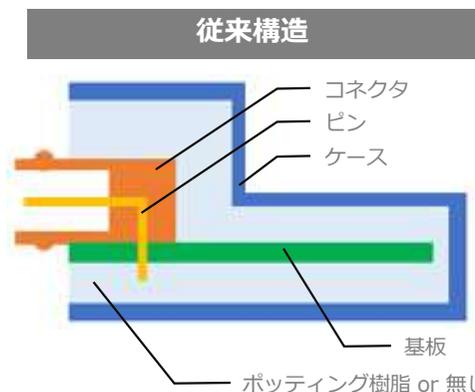
- ①ICチップ、電子部品など 回路基板に実装された状態での樹脂封止
- ②樹脂材料はエポキシ樹脂によるトランスファー成形
- ③コネクタ部も含めた一括封止

業務提携先である日邦産業の保有する商材（トランスファー成形システムおよび成形材料、副資材）と、当社ミタチ産業の保有する商材（電子部品および実装基板）を組合せ、車載用コントロールユニット等を製造されているお客様へ、日邦産業と共に『電子部品一括封止プロセス』（※コンセプト）の提案活動に取り組んでおります。

ミタチ産業株式会社
2021年12月24日



一括封止イメージ



※ケースとポッティング樹脂は不要

コンセプト	ポッティング		インジェクション		トランスファー一括封止			
イニシャル	ケース生産設備	要	△	ケース生産設備のみ	○	トランスファ成形設備のみ	○	
	ポッティング注入設備	要						
品質	封止気密性・信頼性検証	要	△	射出圧力による実装部品へのダメージ	×	封止気密性・信頼性検証	要	△
	部品点数	増				部品点数	小	
生産能力	硬化時間	数時間	×	大量生産に向く	○	硬化時間	数分	○

従来のコントロールユニットの構造におけるケースやポッティング（注型）材を使用せず、実装基板やコネクタ等をトランスファー成形による一括封止成形構造とすることで、コントロールユニットの小型化や製造工程の簡素化に寄与するプロセスの提案をしております。電子部品の調達や実装基板、封止樹脂材料の選定、トランスファー成形システム（成形機、金型）の導入までご提案をさせていただきます。また、開発段階における試作の受託も承ります。

※記載の情報は発行日現在のコンセプト内容につき、予期なく変更をさせていただきますこと御座います、

【お問合せ先】

日邦産業お取引様先、他 : <https://www.nip.co.jp/inquiry/>
ミタチ産業お取引様先 : <https://www.mitachi.co.jp/contact/>